DERWENT-ACC-NO:

2002-286724

DERWENT-WEEK:

200233

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Silicon oxide porous compact as raw material for vapor

deposition film used for anti-reflective coating,

comprises silicon oxide and has specified bulk specific

gravity and specific surface area

PATENT-ASSIGNEE: DENKI KAGAKU KOGYO KK[ELED]

PRIORITY-DATA: 2000JP-0170027 (June 7, 2000)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

JP 2001348656 A December 18, 2001 N/A 004 C23C

014/24

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP2001348656A N/A 2000JP-0170027 June 7, 2000

INT-CL (IPC): C04B035/14, C04B038/00, C23C014/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2001348656A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The porous compact comprises silicon oxide (SiOx) as main component,

where x is greater than 0.8 and less than or equal to 1.5. The compact has bulk specific gravity of 0.4-1.2 and specific surface area of 10 m2/g or more.

USE - As raw material for SiOx vapor deposition film for anti-reflective coating of optical lens, gas cut-off property film for food packaging, etc.

ADVANTAGE - Uniform SiOx vapor deposition film with low vapor deposition temperature and high vapor rate is obtained. The SiOx porous compact has excellent productivity and low energy consumption during the production of vapor deposition film.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/1

TITLE-TERMS: SILICON OXIDE POROUS COMPACT RAW MATERIAL VAPOUR DEPOSIT FILM ANTI

REFLECT COATING COMPRISE SILICON OXIDE SPECIFIED BULK

SPECIFIC

GRAVITY SPECIFIC SURFACE AREA

DERWENT-CLASS: L02 M13

CPI-CODES: L02-A02; L02-G01B; M13-F;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2002-084318

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001—348656 (P2001—348656A)

(43)公開日 平成13年12月18日(2001.12.18)

(51) Int.CL'		識別記号	ΡI		テーマコード(参考)		
C 2 3 C	14/24		C 2 3 C	14/24	E	4G019	
C04B	35/14		C 0 4 B	35/14		4G030	
	38/00	303		38/00	303Z	4 K O 2 9	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

(21)出魔番号	特願2000-170027(P2000-170027)	(71)出題人	000003296			
(DA) ETHERET . A	142000 11000.(12000 11000.)	(17)	電気化学工業株式会社			
(22)出顧日	平成12年6月7日(2000.6.7)	東京都千代田区有楽町1丁目4番1				
		(72)発明者	市川 恒希 福岡県大牟田市新開町1 電気化学工業株 式会社大牟田工場内			
		(72)発明者	吉田 昭夫 福岡県大牟田市新開町1 電気化学工業株 式会社大牟田工場内			
		(72)発明者	田中 弘勝 福岡県大牟田市新開町1 電気化学工業株 式会社大牟田工場内			
			最終質に続く			

(54) 【発明の名称】 SiOx多孔質成形体

(57)【要約】

【課題】蒸着用原料として用いたときに、蒸着温度が低くかつ蒸発速度が速く、蒸着効率がよいことを特徴とするSiOx多孔質成形体を提供すること。

【構成】 $SiOx(0.8 < x \le 1.5)$ を含有し、かさ比重 $0.4 \sim 1.2$ 、比表面積 $10m^2/g$ 以上であることを特徴とする多孔質成形体。またSiOx多孔質成形体からなることを特徴とする蒸着用原料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 SiOx (0.8<x≤1.5)を主成 分とし、かさ比重0.4~1.2、比表面積10m2/ g以上であることを特徴とするSiOx多孔質成形体。 【請求項2】 球形であることを特徴とする請求項1記 載のSiOx多孔質成形体。

【請求項3】 請求項1または2記載のSiOx多孔質 成形体からなることを特徴とする蒸着用原料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ガス遮断性フィル ム、反射防止膜等に有用なSiOx膜の蒸着用原料とし て好適なSiOx多孔質成形体およびそれを用いた蒸着 用原料に関する。

[0002]

【従来の技術】光学レンズの反射防止等の保護膜や食品 包装用のガス遮断性フィルムとしてSiOx蒸着膜が用 いられている。その蒸着用原料としては、金属ケイ素と 二酸化ケイ素の混合物を真空炉中で反応生成させた蒸気 いう工程上粉立ちを防ぐために粉末は用いられていな 11

【0003】しかしながら、上記の方法で得られたSi Ox塊状物は緻密であるために蒸着温度が1300℃前 後と比較的高く、内部応力によって割れやすく大型のも のを得にくいと問題がある。また、製造工程が複雑であ り、製造収率が低いため経済的に不利である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記に鑑み 用いたときに、蒸着温度が低くかつ蒸発速度が速く、蒸 着効率が良好なSiOx多孔質成形体を提供することで ある。

[0005]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明はSi Ox (0.8<x≤1.5)を含有し、かさ比重0.4 ~1.2、比表面積10m2/g以上であることを特徴 とするSiOx多孔質成形体である。特に、上記SiO x多孔質成形体が球状であることが好ましい。また、本 発明の上記SiOx多孔質成形体は蒸着用原料として好 40 適に用いることができる。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明の蒸着膜用原料としてのS i O x 多孔質成形体の x 値は 0.8 < x ≤ 1.5 であ り、1.0<x<1.2がより好ましい。これは、x値 が0.8以下であると、蒸着用材料として用いた時、原 料残渣 (金属ケイ素) が多くなり生産性が悪くなるから である。また、x値が1.5を超えると蒸着温度が高く なり生産性が悪くなる。さらに、ガス遮断性フィルムな 着雰囲気を調整することにより蒸着膜のSiOxのx値 を1.5~1.8に上げることによって、生成される蒸 着膜のガス透過性、透光性などをコントロールするの で、蒸着用原料としてはそれ以下のx値であることが望 ましい。

【0007】本発明のSiOx多孔質成形体のかさ比重 は0.4~1.2であり、0.5~0.8がより好まし い。これは、かさ比重が0.4未満であると、壊れやす く、また蒸着用原料として原料容器に充填できる量が少 10 なくなるため、生産性が劣るからである。また、かさ比 重が1.2を超えると緻密な成形体では、耐熱衝撃強度 に劣るため破壊し粉立ちの原因となる。

【0008】本発明のSiOx多孔質成形体の比表面積 は $10m^2/g$ 以上であり、より好ましくは $30\sim20$ O m²/gであり、それによって低い蒸着温度で、蒸 発速度を高くすることができ、蒸着膜の均一化をより容 易に実現することができる。 一方 、 比表面積が10m² /g未満であると、蒸発速度が低下する。

【0009】本発明の蒸着原料用のSiOx多孔質成形 を凝縮させたSiOx塊状物が用いられている。蒸着と 20 体を製造するためのSiOx粉末は、x値が0.8<x ≤1.5であり、比表面積が30m2/g以上、好まし くは50~200m²/gであるものが好ましい。99 %以上の高純度でSiOxを含有することが望ましい が、生成された膜の性質に悪影響を与えない範囲で、金 属不純物、及び窒素、炭素等を含んでいても良い。

【0010】本発明に用いるSiOx粉末は、例えば、 特願平11-342813号明細書、特願2000-2 288号明細書にあるような、SiOxガスを急冷する ことにより製造されたものが望ましい。こうして得られ てなされたものであり、その目的は、蒸着用原料として 30 たSiOx粉末は、非常に活性が高いため、蒸着用材料 として成形体として使用した場合、蒸着温度が低く、蒸 発速度が速いので有利である。

> 【0011】SiOx多孔質成形体を得る方法として は、特に限定されるものではないが、上記のSiOx粉 末を、加圧成形、押出、射出等の方法のいずれも用いる ことができるが、本発明には、加圧成形、例えば、金型 成形法、CIP法が好ましい。強度を高めるために、焼 結、仮焼等の処理を行うのが望ましい。

> 【0012】金型成形法およびCIP成形法による成形 の条件は、かさ比重0.4~1.2、比表面積10m² 以上のSiOx多孔質成形体が得られる範囲であれば特 に制限はない。金型成形は4~8MPaでペレット化す るのが好ましく、特に球状ペレット化するのが好まし い。また、CIP成形は50~100MPaで行うのが 好ましい。圧力が低いと取り扱い時に崩れる等の問題が あり、圧力が高いと割れが生じるといった問題が生じ

【0013】焼結および仮焼の方法としては、電気炉に よりAr雰囲気中1000~1400℃で焼結する方法 どは、例えば積極的に酸素を導入する方法によって、蒸 50 が好ましく、特に、1000~1300℃で焼結するの 3

が好ましい。これは、1000℃未満では焼結が進行せ ず強度向上が望めないからである。また、1400℃を 超えると緻密化が進行しSiOx成形体の比表面積が低 下するために、蒸着用原料として用いるとき蒸着温度が 高くなってしまうという問題があるためである。

【0014】本発明のSiOx多孔質成形体の形状は、 板状、円柱等、特に制限されるものではないが、球形で あるものが好ましい。ここで、球形とは単に真球状のみ を指すのではなく、例えば、ラグビーボール状のもので も差し支えない。更に詳しく述べると、アスペクト比 (長軸a/短軸b) が2以下で、曲率R<a/3のもの が好ましい。SiOx多孔質成形体のアスペクト比及び 曲率R値が上記の範囲にあると、異常蒸発を生じるコー ナー部を減少させることにより、成形体の部位による蒸 発量の差が無くなり、従って蒸着膜のムラをなくすのに 効果的である。

[0015]

【実施例】 以下、実施例、比較例を挙げて更に具体的 に本発明を説明する。

【0016】実施例1~5、比較例1~3 特願平11-34281号明細書の実施例1に開示され た方法を用いて、表1に示すx値および比表面積を有す るSiOx粉末を調製した。ただし、比較例1について はフルウチ社製SiO粉末を用いた。各SiOx粉末を* *表1に示す条件にて加圧成形(理研精機社製「手動プレ ス機」) 及び/又はCIP成形(神戸製鋼所社製「湿式 冷間静水圧加圧装置」)したものを、必要に応じて電気 炉(富士電波工業社製「抵抗加熱式真空加圧焼結炉」) で焼結し、SiOx多孔質成形体を得た。金型を変える ことによって、円柱状及び球状の成形体を得た。

【0017】得られたSiOx多孔質成形体について、 SiOxのx値、かさ比重、比表面積を以下の方法に従 って評価した。それらの結果を表1に示した。

【0018】(1)SiOx粉末のx値は、Siのモル 量をJIS-R6124(炭化ケイ素質研削材の化学分 析)に準じて測定した。酸素のモル量をO/N同時分析 装置 (例えばLECO社「TC-136」) を用いて測 定し、式、x=(1.75×O値/100)/(1-(O値/100))、によって、算出する。SiOx膜 のx値はXPS (X線光電子分光法)で、Si2Pの結 合エネルギーを測定し、SiおよびSiO2の結合エネ ルギーの値から算出する。

(2)かさ比重は成形体の寸法および重量から計算し 20 た。

(3) 比表面積は、BET法により測定した。

[0019]

【表1】

	粉体特性		成形条件			成形体特性			
	比表面積 (m²/g)	×植	金型 成形圧 (MPa)	CIP 成形圧 (MPa)	焼結 温度 (℃)	双值	かさ比重	比波面積 (m ⁴ g)	形状
実施例 1	80	1.3	5	90	_	1.1	0.6	70	円柱
実施例 2	80	1.1	4	0	1000	1.1	0.4	50	門柱
実施例	80	1.1	5	90	1400	1.1	1.2	30	円柱
実施例 4	80	1.1	5	90	1000	1.1	0.4	50	球状
実施例 5	80	1.5	5	90	1400	1.5	1,2	30	球状
比較例 1	4	1.1	5	90	1200	1.1	1.8	4	四柱
比較例 2	80	1,3	5	0	-	1.1	0.3	80	門柱
比較例 3	80	1.8	5	90	1200	1.8	0.6	35	円柱

平8-325712号公報の図1と同等の装置にて1. 3×10-3Paの真空中で、蒸着温度1000、110 0、1200、1300および1400℃でPETフィ ルムに蒸着した。

【0021】各蒸着温度における蒸発速度は試験前と試 験後の原料重量差を、試験時間と蒸着された基材の面積 の積で割ることにより求めた。この蒸着試験結果は図1 に示した。 蒸着膜のSiOx組成を上記の方法によって 測定した結果、x値は蒸着用原料のSiOx多孔質成形 体とほぼ同じ値であった。

【0020】表1に示す各SiOx多孔質成形体を特開 40%【0022】実施例4で得られた蒸着フィルムは、実施 例2より得られた蒸着フィルムに対して、より均一な厚 みを示した。

> 【0023】比較例2で得られた成形体は非常に脆いた め破壊しやすく、蒸着膜に粉立ちし膜にブツを生じさせ るため蒸着用原料として不適切であった。また、比較例 3で得られた成形体では、蒸着温度を1600℃に上げ てもほとんど蒸着しなかった。

【0024】表1及び図1からわかるように、本発明の SiOx多孔質成形体は、比較例1に比べてより低い蒸 ※50 着温度においても十分な蒸発速度が得られるので、蒸着

5

用原料として優れていることが示された。 【0025】

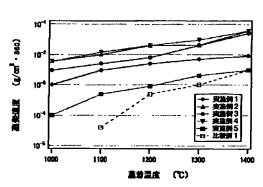
【発明の効果】本発明の、SiOx多孔質成形体によれば低素着温度、高蒸発速度で均一なSiOx蒸着膜を得

ることが出来るので、蒸着膜の生産時のエネルギー消費 が少ない、生産性に優れる等の効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】蒸着温度と蒸発速度の関係図である。

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 今村 保男

福岡県大牟田市新開町 1 電気化学工業株式会社大牟田工場内

F ターム(参考) 4G019 FA11 FA15 4G030 AA37 BA32 CA07 CA09 4K029 AA11 AA25 BC07 BD00 DB05 DB07